

SMT表面组装技术



[SMT表面组装技术_下载链接1](#)

著者:杜中一 编

出版者:

出版时间:2009-1

装帧:

isbn:9787121078514

《SMT表面组装技术》主要包括：电子制造技术概述、表面组装元器件、印制电路板技术、焊膏印刷技术、贴片胶涂敷技术、贴片技术、波峰焊技术、再流焊技术、清洗及返修技术、测试技术等SMT相关的基础知识及实用技术。

《SMT表面组装技术》力求完整地讲述SMT各个技术环节，并注意教材的实用性。在内容上接近SMT行业的实际情况，知识及技术贴近于SMT产业的技术发展及SMT企业对岗位的需求。通过阅读《SMT表面组装技术》，读者能够方便地认识到SMT行业的技术及工艺流程。

作者介绍:

目录:

[SMT表面组装技术_下载链接1](#)

标签

评论

[SMT表面组装技术_下载链接1](#)

书评

[SMT表面组装技术_下载链接1](#)